

用語説明

1．産業一般に関わる用語

CKD（Complete Knockdown）部品からの組立生産。

SKD（Semi-Knockdown）半完製品からの組立生産。一般にCKDより難易度が低い。

EMS（Electronics Manufacturing Service）電子製品の組立を行う製造受託専門事業者。

OEM（Original Equipment Manufacturing）顧客企業側のブランドによる製造受託取引。

ODM（Original Design Manufacturing）OEMの発展形態として、顧客企業側のブランドにより受託企業側が設計と製造を行う取引。

OBM（Own Brand Manufacturing）自社ブランドによる事業。

2．移動体通信・携帯電話端末産業に関わる用語

プロトコル（Protocol）特定の通信形態ごとに定められた通信規格。国際電気通信連合（The International Telecommunication Union）が国際規格の認定を行う。通信端末に組み込まれるプロトコルを体化したソフトウェアを、プロトコル・スタック（Protocol Stack）と呼ぶ。

GSM（Global System for Mobile Communications）欧州を中心に開発された第二世代（2G）移動体通信規格。デジタル移動体通信の規格としては現在世界的に最も普及している。GPRS（General Packet Radio Service）はパケット通信を可能にしたGSMの発展版（2.5G）。

CDMA（Code Division Multiple Access）デジタル移動体通信技術の一種で、複数の通話を異なる符号に振り分けて同一の周波数に載せ、音質の向上

や伝送速度の向上を実現する。アメリカ・クアルコム（Qualcomm）が同技術に基づいて開発した第二世代移動体通信規格はcdmaONE，第三世代（3G）CDMAはCDMA2000と称され，アメリカ，韓国，日本などで採用されている。

W-CDMA(Wideband CDMA) CDMA技術を採用して欧州・日本が中心となって開発した第三世代移動体通信規格。3G規格としては現在世界的に最も普及している。

TD-SCDMA(Time-Division- Synchronized CDMA) 中国が独自規格として推進している第三世代移動体通信規格。ドイツ・シーメンス（Siemens）が開発した技術を母体とする。

ベースバンド（Baseband）LSI 移動体通信端末で音声信号の処理を司るLSI。RF回路と並ぶ通信端末の中核コンポーネントである。

RF（Radio Frequency）回路 移動体通信端末で無線通信を司る回路。

プラットフォーム（Platform）プラットフォームという概念はいくつかの異なる意味で用いられる。主な用法としては次の2つがある。ベースバンドLSIを中核とするチップセットと駆動ソフトウェアの組み合わせ（RF回路を含むこともある）。端末の回路の論理設計・物理設計を含むものをレファレンス・デザイン（reference design）と呼ぶこともある。これらは通信機器メーカーや半導体メーカーなどによって，セットメーカーやデザインハウス向けに供給される。セットメーカーの携帯電話端末の基本モデル。これを基盤として外観や機能の一部を変更して派生モデルを開発するという戦略が，しばしば採用される。

FTA（Full Type Approval）通信端末に義務付けられている通信機能・電波輻射などに関わる認証のための試験。